

第 36 回マイクロエレクトロニクス研究会プログラム

2024 年 11 月 9 日

会場: 東北大学 環境科学研究科総合研究棟 大講義室

13:00~13:40 「半導体デバイスを支える X 線計測技術とその展望」

株式会社リガク 薄膜デバイス事業部
松嶋 直樹

13:40~14:20 「CMP の起源とイノベーション」

株式会社フジミインコーポレーテッド
森永 均

14:20~15:00 「高 SNR・高速グローバルシャッタ CMOS イメージセンサによるリアルタイム流体濃度分布計測」
東北大学 未来科学技術共同研究センター
東北大学大学院工学研究科
間脇 武蔵

15:00~15:20 休憩

15:20~16:00 「次世代パワーデバイス応用に向けた縦型 GaN MOSFET の高性能化技術」

富士電機株式会社
上野 勝典

16:00~16:40 「チップオンウェハダイレクト接合技術の開発」

ヤマハロボティクスホールディングス株式会社
戸張 優太

The 36th International Microelectronics Conference Program

Nov.9, 2024

Venue: Main Building, Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University

- 13:00~13:40 “X-ray metrology for advanced semiconductor devices and its outlook”
Semiconductor Metrology Division, Rigaku Corporation
Naoki Matsushima
- 13:40~14:20 “Origin and Innovations of CMP”
Fujimi Incorporated
Hitoshi Morinaga
- 14:20~15:00 “Real-time Fluid Concentration Distribution Measurement Using High SNR High speed Global Shutter
CMOS Image Sensors”
New Industry Creation Hatchery Center, Tohoku University
Graduate School of Engineering, Tohoku University
Takezo Mawaki
- 15:00~15:20 Break
- 15:20~16:00 “High-Performance Enhancement Techniques for Vertical GaN MOSFETs Toward Applications in
Next Generation Power Devices”
Fuji Electric Co., Ltd.
Katsunori Ueno
- 16:00~16:40 “Elemental Technology Development of Chip-on-Wafer Direct Bonding”
Yamaha Robotics Holdings Co., Ltd.
Yuta Tobari